****

|  |  |
| --- | --- |
| **Leserkontakt:** | **Pressekontakt:** |
| **congatec AG** | **SAMS Network**  |
| Christian Eder | Michael Hennen |
| Telefon: +49-991-2700-0 | Telefon: +49-2405-4526720 |
| info@congatec.com [www.congatec.com](http://www.congatec.com)  | info@sams-network.com [www.sams-network.com](http://www.sams-network.com)  |

**

*Text und Foto verfügbar:* [*http://www.congatec.com/presse*](http://www.congatec.com/presse)

Produktvorstellung

**congatec erhöht die Performance seiner COM Express Basic Module mit den neuesten Intel® Xeon® und Gen 7 Intel® Core™ Prozessoren (Codename Kaby Lake)**

**congatec beschleunigt das modulbasierte
High-End Embedded Computing**

**Deggendorf, 3. Januar 2017 \* \* \*** congatec, ein führender Technologie-Anbieter für Embedded Computermodule, Single Board Computer und Embedded Design & Manufacturing Services, erweitert sein COM Express Basic Portfolio um die neuen leistungsstarken conga-TS175 Computer-on-Module. Mit den High-End Dual-Chip Versionen der brandneuen Intel® Xeon® und Intel® Core™ Prozessoren der 7ten Generation setzen sie einen neuen Benchmark für modulbasierte High-Performance Embedded Computer und modulare, industrielle Workstations, die allesamt hohen Rechenlasten zu verarbeiten haben.

Anwendungsbereiche für diese High-End COM Express Typ 6 Server-on-Module finden sich überall dort, wo massive Datenströme in Echtzeit verarbeitet und visualisiert werden müssen. Zu den Zielmärkten zählen Big-Data verarbeitende Embedded Cloud-, Edge- und Fog-Server sowie Systeme für die medizinische Bildverarbeitung, Videoüberwachung und bildgebende Qualitätskontrolle. Weitere Anwendungsbereiche sind Simulationssysteme, Host-Systeme für virtualisierte Steuerungstechnik, Visualisierungsrechner in industriellen Leitständen und anderen fabrikweiten Überwachungssystemen sowie professionelles High-End Gaming und Digital Signage.

Im Vergleich zu ihren Vorgängern (Codename Skylake) bieten die neuen Module eine höhere CPU-Taktung und mehr Performance, eine dynamischere HDR Grafik durch 10 bit Video Codecs mit 10 bit Support sowie die Unterstützung des ultra-schnellen 3D Xpoint basierten Intel® Optane™ Speichers. Gegenüber den Single-Chip Varianten der neuen Intel® Core™ Prozessoren der 7ten Generation setzen sie im Embedded Leistungssegment bis 45 Watt einen neuen Benchmark für High-End Server-on-Module Applikationen und für Anwendungsfälle mit Hyperthreading.

„Die neuen Module werden die Art und Weise, wie wir massive Datenströme nutzen, signifikant verändern, da sie den neuen Intel® Optane ™ Speicher unterstützen, der auf der 3D XPoint Technologie basiert. Er besticht im Vergleich zu NAND SSDs durch deutlich geringere Latenzen bei der Verarbeitung von gleichgroßen Datenpaketen. Gegenüber Standard-Festplatten ist seine Latenz von nur 10 Mikrosekunden sogar tausendmal kleiner. Als Folge kann die Reaktionsgeschwindigkeit von Applikationen wie Big-Data Verarbeitung, High-Performance Computing, Virtualisierung, Datenspeicherlösungen, Clouds und Computerspielen durch den Einsatz von Computer-on-Modulen, die diesen extrem schnellen und kosteneffizienten nichtflüchtigen Speicher unterstützen, massiv verbessert werden”, erklärt Martin Danzer, Director Product Management bei congatec.

**Das Featureset im Detail**

Das neue conga-TS175 COM Express Basic Modul ist mit zwei Intel® Xeon® Prozessoren und Hyperthreading sowie 5 unterschiedlichen Intel® Core™ i7, i5 und i3 Prozessoren in einem TDP-Bereich von 45 bis 25 W TDP erhältlich. Bandbreitenintensive Applikationen profitieren von bis zu 32 Gigabyte schnellem Dual-Channel DDR4-2400 Speicher – optional auch mit ECC-Support. Für ein hochwertiges Grafikerlebnis integrieren sie die neue Intel® HD630 Grafik, die bis zu drei unabhängige Displays mit Auflösungen von bis zu 4k bei 60 Hz über DisplayPort 1.4 und HDMI 2.0 – beide mit HDCP 2.2 – sowie eDP 1.4 unterstützt. Für Legacy-Displays stellen die Module zusätzlich einen Dual-Channel LVDS- und VGA-Ausgang zur Verfügung. Mit der hardwarebeschleunigten 10-bit HEVC- und VP9-En- und Dekodierung von High Dynamic Range Videos wirken HD Videostreams in beide Richtungen lebendiger und naturgetreuer.

Die COM Express Server-on-Module bieten alle typischen I/Os des Typ 6 Pinouts. Leistungsfähige Erweiterungsoptionen inklusive des Intel® Optane™ Speichers können über zahlreiche PCI Express Graphics Gen 3.0 Lanes angebunden werden. Für konventionelle Speichermedien stehen 4x SATA 3.0 inklusive RAID 0/1 Support zur Verfügung. Zu den weiteren I/Os zählen 1x Gigabit Ethernet mit Intel® AMT Support, 4x USB 3.0, 8x USB 2.0, HDA, 4x GPIO, LPC, SPI, I2C Bus und 2x UART. Die Module unterstützen die 64 bit Versionen von Microsoft Windows 10 und Windows 10 IoT sowie die gängigen Linux Betriebssysteme. Individueller Integrationssupport, umfassendes Zubehör sowie optionale Embedded Design & Manufacturing Services für individuelle Carrierboard- und Systemdesigns runden das Angebot ab.

Die neuen conga-TS175 COM Express® Basic Module sind in den folgenden Standardkonfigurationen verfügbar:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prozessor** |  | **Cores / Threads** |  | **Intel® Smart Cache [MB]** |  | **Clock / Burst****[GHz]** |  | **TDP** **[W]** |
| **Intel® Xeon® E3-1505M v6** |  | 4/8 |  | 8 |  | 3.0/4.0 |  | 45/35 |
| **Intel® Xeon® E3-1505L v6** |  | 4/8 |  | 8 |  | 2.2/3.0 |  | 25 |
| **Intel® Core™ i7-7820EQ** |  | 4/8 |  | 8 |  | 3.0/3.7 |  | 45/35 |
| **Intel® Core™ i5-7440EQ** |  | 4/4 |  | 6 |  | 2.9/3.6 |  | 45/35 |
| **Intel® Core™ i5-7442EQ** |  | 4/4 |  | 6 |  | 2.1/2.9 |  | 25 |
| **Intel® Core™ i3-7100E** |  | 2/4 |  | 3 |  | 2.9 |  | 35 |
| **Intel® Core™ i3-7102E** |  | 2/4 |  | 3 |  | 2.1 |  | 25 |

Weitere Informationen zu den neuen COM Express Basic conga-TS175 Server-on-Modulen unter: <http://www.congatec.com/de/produkte/com-express-typ6/conga-ts175.html>

**Über die congatec AG**

Mit Hauptsitz in Deggendorf, Deutschland ist die congatec AG ein führender Anbieter von industriellen Computermodulen auf den Standard-Formfaktoren COM Express, Qseven und SMARC sowie für Single Board Computer und EDM-Services. Die Produkte und Dienstleistungen des innovativen Unternehmens sind branchenunabhängig und werden z.B. in der Industrie-Automatisierung, der Medizintechnik, im Entertainment, im Transportwesen, bei Telekommunikation, Test & Measurement sowie Point-of-Sale Anwendungen eingesetzt. Wesentliche Kernkompetenz und technisches Know-How sind besondere, erweiterte BIOS Features sowie umfangreiche Treiberunterstützung und Board Support Packages. Die Kunden werden ab der Design-In Phase durch umfassendes Product Lifecycle Management betreut. Die Fertigung der Produkte erfolgt bei spezialisierten Dienstleistern nach modernsten Qualitätsstandards. congatec unterhält Niederlassungen in USA, Taiwan, China, Japan und Australien sowie in Großbritannien, Frankreich und Tschechien. Weitere Informationen finden Sie unter [www.congatec.de](http://www.congatec.de) oder bei [Facebook](http://www.facebook.com/Congatec), [Twitter](https://mobile.twitter.com/congatecAG) und [YouTube](http://www.youtube.com/congatecAE).

\* \* \*

*Intel® und Intel® Xeon, Core und Optane sind eingetragene Warenzeichen der Intel® Corporation in den USA und anderen Ländern.*